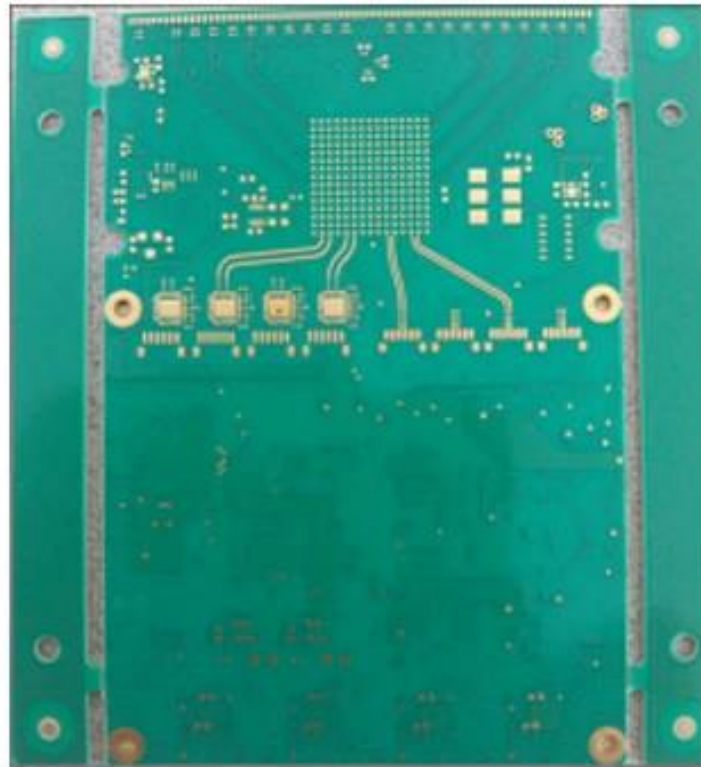


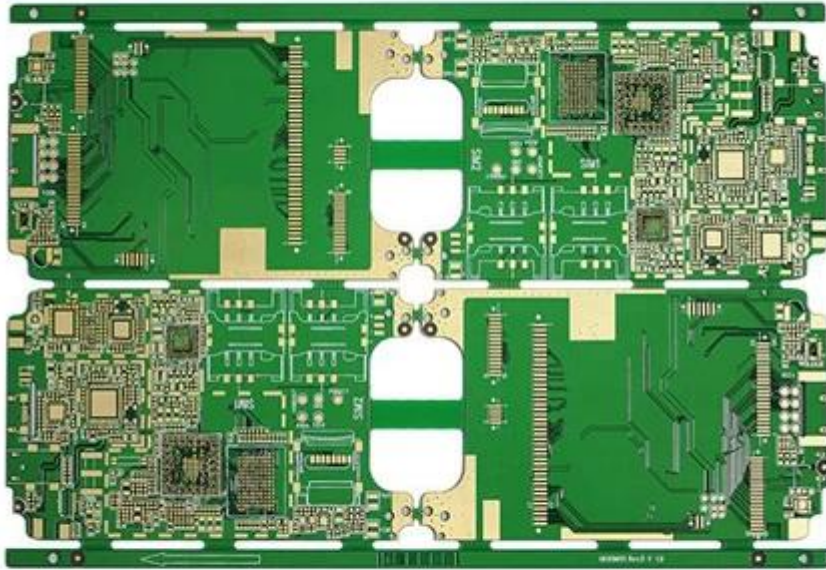
Fori di rame piastra minima .025 AVG,. 020 min.. I fori non possono essere collegati
 Questo PN richiesto 10% di impedenza, 8mil laser Drill, POFV, accatastati via, laser cieco tramite
 trapano attraverso 6mil dielettrico e la spina e la placcatura piatta via

Imballi con la pellicola trasparente incolore della bolla, 25 pc/sacchetto, dissecante messo nel
 fianco, metta la scheda dell'indicatore di umidità sul lato superiore

Struttura del layer

Custom Info Lyr	Image	Foil	Name
COMP		0.5oz	Foil 1/2oz(RTF)
6+/-0.9mil			R-5670K 1080 RC64%
			R-5670K 1080 RC64%
L2		0.5oz	Foil 1/2oz(RTF)
3.9+/-0.7mil			R-5670K 3313 RC54%
L3		0.5oz	
L4		0.5oz	R-5775K 0.200mm H/H 42.5"49"(3313*2)(RTF)
			R-5670K 1080 RC64%
6.9+/-1.5mil			R-5670K 3313 RC54%
L5		0.5oz	R-5775K 0.100mm H/H 42.5"49"(3313*1)(RTF)
L6		0.5oz	
			R-5670K 3313 RC54%
6.9+/-1.5mil			R-5670K 1080 RC64%
L7		0.5oz	R-5775K 0.200mm H/H 42.5"49"(3313*2)(RTF)
L8		0.5oz	
3.9+/-0.7mil			R-5670K 3313 RC54%
L9		0.5oz	Foil 1/2oz(RTF)
			R-5670K 1080 RC64%
6+/-0.9mil			R-5670K 1080 RC64%
SOLD	0.5oz	Foil 1/2oz(RTF)	





www.o-leading.com

[Circuito stampato PCB società manifatturiera, PCB prototipo fabbricante Cina](#)